

2025年3月19日

各 位

会 社 名 ニデック株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 岸田 光哉
取 引 所 東証プライム (6594)
所 在 地 京都市南区久世殿城町 338
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 渡邊 啓太
電 話 (075) 935-6150

当社子会社の SEMICON China 2025 への出展について

ニデック株式会社のグループ会社であるニデックアドバンステクノロジー株式会社及びニデックインスツルメンツ株式会社は、3月26日(水)～3月28日(金)に上海新国際博覧中心で開催される「SEMICON China 2025」に出展いたします。

2025年3月19日

各位

会社名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所在地 京都府向日市森本町東ノ口1-1
ニデックパークC棟

SEMICON China 2025 への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2025年3月26日（水）～3月28日（金）に上海新国際博覧中心で「SEMICON China 2025」に出展します。



本展示会はチップの設計・製造・パッケージング・測定・設備・材料など、半導体産業をカバーする、中国最大規模となる展示会です。1,000社を超える企業が集結し、4,500を超えるブースが設けられます。

当社はグループ会社のニデックインストルメンツ株式会社と共同出展し、『Wafer Testing and Wafer Handling』をテーマに、ウェハ製造プロセスにおいて当社の光学外観検査装置、プローブカード、そしてニデックインストルメンツの搬送ロボットといった最先端の検査・搬送製品ソリューションを提案いたします。

また、最近注目を集めているパワー半導体に関しても当社の新技術と新製品を紹介いたします。是非当社ブースへお越しください。

〈出展概要〉

- ・会期：2025年3月26（水）～28日（金）
- ・会場：上海新国際博覧中心
- ・ブース：E7861
- ・公式サイト：<https://www.semiconchina.org/>

〈主な展示内容〉

- ・半導体ウェハ向け光学式 2D/3D 検査装置「RWi300MK シリーズ」
- ・IGBT/SiC パワーモジュール検査装置「NATS シリーズ」
- ・半導体パッケージ対応導通/短絡検査装置「GATS シリーズ」
- ・高密度基板対応光学式 2D/3D 検査装置「RSH シリーズ」
- ・半導体ウェハ検査用プローブカード
- ・半導体ウェハ搬送ロボット「SR8220、SR8241」
- ・FO-PLP 搬送ロボット「SR9188」
- ・AC サーボアンプ&モータ「S-FLAG ダイナミックモーションシリーズ」